Market News

Neuer i-ToF-Imager ermöglicht kleinste 3D-Kamerasysteme mit verbesserter Quanteneffizienz bei optimierten Kosten

München – 24. Februar 2023 – Die Infineon Technologies AG stellt in Zusammenarbeit mit dem 3D-Time-of-Flight-Spezialisten und Premium-Partner pmdtechnologies den Time-of-Flight (ToF) VGA-Sensor IRS2976C vor. Dabei handelt es sich um eine leistungsstärkere Weiterentwicklung des ToF-VGA-Sensors IRS2877C und ein neues Mitglied der REAL3™-Produktfamilie.

Durch die Verwendung der fortschrittlichen Pixeltechnologie von Infineon erreichen die Pixel eine Quanteneffizienz von 30 Prozent und mehr. Das ist ein Wert, der bisher nur von Back-Side-Illumination (BSI)-Sensoren erreicht wurde. Gleichzeitig wird der Kostenvorteil von Front-Side-Illumination-Sensoren (FSI) beibehalten. Als Ergebnis ist der IRS2976C-Sensor der erste ToF-Imager der Welt, der Googles Klasse-3-Zertifizierung (Strong) für Gesichtserkennung bestanden hat und dabei problemlos direkt unter dem Display des Mobilgeräts eingesetzt werden kann.

Der IRS2976C-Imager unterstützt eine Reihe von Anwendungen mit einer großen Reichweite und geringem Stromverbrauch, die einen messbaren Bereich von 10 Metern und mehr ermöglichen. Wie bei allen Mitgliedern der REAL3™-Familie ist die patentierte Suppression of Background Illumination (SBI)-Technologie von pmdtechnologies in jedem Pixel integriert. Diese sorgt für zuverlässige Daten in Umgebungen mit hohem Dynamikbereich (HDR) und Sonnenlicht.

„Unser einzigartiger ToF-CMOS-Prozess sorgt für hervorragende Empfindlichkeit und zuverlässigen Gebrauch in Innen- und Außenbereichen“, sagt Christian Herzum, Vice President 3D-Sensing bei Infineon. „Darüber hinaus bietet unser 3D-ToF-Imager IRS2976C ein hohes Maß an Funktonalität und ein Maximum an Flexibilität zur Optimierung von 3D-Kameradesigns. Der Sensor ist ideal für Anwendungen wie sichere Authentifizierung auf Smartphones, Zahlungsterminals, intelligente Türschlösser und auch für Virtual- und Augmented-Reality-Headsets (AR/VR), Serviceroboter und andere IoT-Geräte.“

Public / Für die Fachpresse
Informationsnummer INFPSS202302.067d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Reinhard von Faltin
Tel.: +49 89 234 39694
reinhard.vonfaltin@infineon.com

Investor Relations:
Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com

Der IRS2976C bietet eine VGA-Systemauflösung von 640 x 480 Tiefenpunkten. Mit dem weltweit kleinsten Formfaktor von 23 mm² ist der Sensor Drop-in-kompatibel zum Vorgänger IRS2877C und ermöglicht einen einfachen Upgrade-Prozess. Der hohe Integrationsgrad ermöglicht eine reduzierte Stückliste (BOM), kleinste Formfaktoren und ein vereinfachtes Design. In Kombination mit dem IRS9102C, dem neuesten VCSEL-Treiber von Infineon, erlaubt der neue IRS2976C die Entwicklung kleinster 3D-Kamerasysteme zu optimierten Kosten.

Verfügbarkeit

Entwicklungsmuster des IRS2976C-Imagers sind verfügbar. Das neue Produkt wird auf dem Mobile World Congress 2023 in Barcelona, Spanien, vorgestellt. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/real3.

Infineon auf dem Mobile World Congress 2023

Der Mobile World Congress 2023 findet vom 27. Februar bis 2. März 2023 in Barcelona, Spanien, statt. Unter dem Motto „Driving decarbonization and digitalization. Together.“ zeigt Infineon in Halle 5a am Stand 51 und virtuell, wie die neuesten Halbleitertechnologien Smart Homes, Smart Factories und kabellose Infrastrukturen verändern. Informationen zu den Show Highlights des MWC sind erhältlich unter www.infineon.com/mwc.

Public / Für die Fachpresse
Informationsnummer INFPSS202302.067d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Reinhard von Faltin
Tel.: +49 89 234 39694
reinhard.vonfaltin@infineon.com

Investor Relations:
Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com